

杭州士兰微电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，现将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 2018 年非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主承销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象非公开发行普通股（A 股）64,893,614 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92 元。扣除承销费、保荐费 25,440,000.00 元（其中进项税额 1,440,000.00 元）后的募集资金为 706,559,965.92 元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2018 年 1 月 3 日汇入本公司在农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立的账号为 19033101040020262 人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 2,405,660.37 元后，本公司本次募集资金净额 705,594,305.55 元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕1 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称士兰集昕公司）、杭州士兰集成电路有限公司（以下简称士兰集成公司）、成都士兰半导体制造有限公司（以下简称成都士兰公司）和成都集佳科技有限公司（以下简称集佳科技公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日余额	备注

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
本公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行 (原杭州下沙支行)	19033101040020262	705,594,305.55	20,898,566.05	募集资金专户
士兰集成公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672700000826		187,276.05	募集资金专户
成都士兰公司	交通银行股份有限公司杭州东新支行	331066080018800024087		6,370,087.42	募集资金专户
士兰集昕公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行 (原杭州下沙支行)	19033101040025451		71,444.27	募集资金专户
集佳科技公司	中国农业银行股份有限公司金堂县支行	22847101040031406		7,745,794.92	募集资金专户
合计			705,594,305.55	35,273,168.71	

前次募集资金投资项目中，年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目实施主体为本公司及子公司士兰集成公司、成都士兰公司，8 吋芯片生产线二期项目实施主体为子公司士兰集昕公司，特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为孙公司集佳科技公司，实施方式为本公司利用募集资金按项目进度对士兰集成公司、成都士兰公司、士兰集昕公司及集佳科技公司进行增资。

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2533 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80 元，共计募集资金 112,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）2,490.00 万元和财务顾问费（不含税）200.00 万元后的募集资金为 109,510.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）311.23 万元后，公司本次募集资金净额为 109,198.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕532 号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及士兰集昕公司前次募集资金在银行账户的存放情况如

下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额	备注
本公司	中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	383180133664	1,091,987,701.65	171,991.05	募集资金专户
士兰集昕公司	中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	366280506835		220,240,030.71	募集资金专户
合计			1,091,987,701.65	220,412,021.76	

前次募集资金投资项目中，8英寸集成电路芯片生产线二期项目实施主体为子公司士兰集昕公司，实施方式为本公司利用募集资金对士兰集昕公司进行增资。

二、前次募集资金使用情况

- (一) 2018年非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1。
- (二) 2021年非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

- (一) 2018年非公开发行募集资金投资项目变更情况

1. 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资金额		核准部门及文号
	总投资额	募集资金投资金额	
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	
其中：MEMS传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	杭州经济技术开发区经济发展局经开经技备案（2017）5号、6号
MEMS传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	金堂县经济科技和信息化局金经信技改备案（2017）1号
MEMS传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	杭州市滨江区发展改革和经济局滨发改体改（2017）003号
合计	80,253.00	80,000.00	

实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金的总金额，本公司将按照项目的轻重缓急，将募集资金用于MEMS传感器芯片制造扩产项目、MEMS传感器封装项目和MEMS传感器测试能力提升项目，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。其中，MEMS传感

器芯片制造扩产项目实施主体为子公司士兰集成公司、MEMS 传感器封装项目实施主体为子公司成都士兰公司，实施方式为募集资金到位后，本公司将利用募集资金对士兰集成公司、成都士兰公司进行增资。

2. 募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

(1) 根据公司 2018 年 1 月 23 日第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目使用募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	原拟用募集资金投入金额	调整后募集资金投入金额
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,253.00	80,000.00	70,559.43
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	37,900.00	37,647.00	30,568.43
MEMS 传感器封装项目	22,362.00	22,362.00	20,000.00
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	19,991.00	19,991.00
合计	80,253.00	80,000.00	70,559.43

(2) 根据公司2019年11月8日第七届董事会第五次会议和2019年11月25日2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目相关事项的议案》，基于产线升级、进一步提高募集资金使用效率等原因，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况对原募投项目的建设期、投资金额等进行调整，同时增加8吋芯片生产线二期项目和特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目作为新增的募集资金投资项目，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

原募投项目	原募集资金投入金额	变更后募投项目	调整后募集资金投入金额	建设期
年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	70,559.43	一、年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	30,559.43	由 2 年调整至 7 年
其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	30,568.43	其中:MEMS 传感器芯片制造扩产项目	10,568.43	
MEMS 传感器封装项目	20,000.00	MEMS 传感器封装项目	10,000.00	
MEMS 传感器测试能力提升项目	19,991.00	MEMS 传感器测试能力提升项目	9,991.00	

原募投项目	原募集资金投入金额	变更后募投项目	调整后募集资金投入金额	建设期
		二、8吋芯片生产线二期项目	30,000.00	5年
		三、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	3年
合计	70,559.43		70,559.43	

其中，8吋芯片生产线二期项目实施主体为子公司士兰集昕公司、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目实施主体为本公司孙公司集佳科技公司。

(二) 2021年非公开发行募集资金不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2018年非公开发行募集资金项目

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目	30,559.43	29,093.17	-1,466.26	尚在建设中
8吋芯片生产线二期项目	30,000.00	30,229.17	229.17	募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目
特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	10,000.00	9,287.27	-712.73	尚在建设中

(二) 2021年非公开发行募集资金项目

单位：人民币万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
8英寸集成电路芯片生产线二期项目	53,098.77	31,323.08	-21,775.69	尚在建设中
偿还银行贷款	56,100.00	56,500.00	400.00	募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目及一般账户划入44.00万元凑整归还借款

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 2018 年非公开发行募集资金项目

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2018 年非公开发行募集资金投资项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

(二) 2021 年非公开发行募集资金项目

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021 年非公开发行募集资金投资项目中的偿还银行贷款项目系偿还上市公司银行贷款，降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2018 年非公开发行募集资金

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2018 年 2 月 6 日本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意本公司使用部分

闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 1 月 2 日将该笔资金归还至募集资金专户。

经 2019 年 1 月 7 日本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,同意本公司使用部分闲置募集资金 14,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 10 月 17 日将该笔资金归还至募集资金专户。

经 2019 年 4 月 11 日本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,同意本公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 3 月 26 日将该笔资金归还至募集资金专户。

经 2019 年 10 月 23 日本公司第七届董事会第三次会议审议通过,同意本公司使用部分闲置募集资金 12,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 7 月 27 日和 2020 年 10 月 16 日将该笔资金归还至募集资金账户。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2. 2018 年非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金购买理财产品情况。

(二) 2021 年非公开发行募集资金

2021 年非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2018 年非公开发行募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 68,609.61 万元,募集资金结余金额为 3,527.32 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 1,577.50 万元),占前次募集资金净额的比例为 5.00%。前次募集资金投资项目部分尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

(二) 2021 年非公开发行募集资金

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 87,823.08 万元,募集资金结余金额为 22,041.20 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 665.51 万元),占前次募集资金净额的比例为 20.18%。前次募集资金投资项目尚处于建设阶段,尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表
4. 2021 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 15 日

附件 1

2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：70,559.43						已累计使用募集资金总额：68,609.61				
变更用途的募集资金总额：40,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：56.69%						2018 年：15,208.82；2019 年：2,856.98；2020 年：26,302.99				
						2021 年：23,868.59；2022 年 1-6 月：372.23				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	80,000.00	30,559.43	29,093.17	80,000.00	30,559.43	29,093.17	-1,466.26	2024 年 12 月
2	8 吋芯片生产线二期项目	8 吋芯片生产线二期项目		30,000.00	30,229.17		30,000.00	30,229.17	229.17	2024 年 12 月
3	特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目		10,000.00	9,287.27		10,000.00	9,287.27	-712.73	2022 年 12 月

附件 2

2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产能 8.9 亿只 MEMS 传感器扩产项目	尚未达产	预计达产后年均税后利润 9,849 万元	-224.11	1,485.25	3,879.44	1,201.31	5,088.49	[注]
2	8 吋芯片生产线二期项目	尚未达产	预计达产后新增年利润总额 20,757.36 万元	未投产	3,280.05	13,710.23	4,506.11	21,496.39	
3	特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目	尚未达产	预计正常生产年新增净利润 4,460 万元	未投产	1,635.10	3,815.01	1,016.85	6,466.96	

[注] 前次募集资金投资项目尚未完全达产，故累计实现效益未达到预计效益

附件 3

2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：109,198.77						已累计使用募集资金总额：87,823.08				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：40,400.00				
						2022 年 1-6 月：47,423.08				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	8 英寸集成电路芯片生产线二期项目	8 英寸集成电路芯片生产线二期项目	53,098.77	53,098.77	31,323.08	53,098.77	53,098.77	31,323.08	-21,775.69	2024 年 12 月
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	56,100.00	56,100.00	56,500.00	56,100.00	56,100.00	56,500.00	400.00	

附件 4

2021 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州士兰微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	8 英寸集成电路芯片生产线二期项目	尚未达产	预计达产后新增年利润总额 20,757.36 万元	未投产	3,280.05	13,710.23	4,506.11	21,496.39	[注]

[注] 前次募集资金投资项目尚未完全达产，故累计实现效益未达到预计效益